cob导热陶瓷基板 氧化铝pcb陶瓷基板

产品名称	cob导热陶瓷基板 氧化铝pcb陶瓷基板
公司名称	深圳市卓立森科技有限公司
价格	10.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:卓立森 型号:ZLS-0023
公司地址	深圳沙井
联系电话	13418547537

产品详情

****

陶瓷基板是指铜箔在高温下直接键合到氧化铝(al2q3)或氮化铝(aln)陶瓷基片表面(单面或双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄复合基板具有优良电绝缘性能，高导热特性，优异的软钎焊性和高的附着强度，并可像pcb板一样能刻蚀出各种图形，具有很大的载流能力。因此，陶瓷基板已成为大功率电力电子电路结构技术和互连技术的基础材料。

用途 ◆ 大功率电力半导体模块；半导体致冷器、电子加热器；功率控制电路，功率混合电路。 ◆智能功率组件；高频开关电源，固态继电器。 ◆汽车电子，航天航空及军用电子组件。 ◆太阳能电池板组件；电讯专用交换机，接收系统；激光等工业电子。特点 ◆机械应力强，形状稳定；高强度、高导热率、高绝缘性；结合力强，防腐蚀。 ◆ 极好的热循环性能，循环次数达5万次，可靠性高。 ◆与pcb板(或ims基片)一样可刻蚀出各种图形的结构；无污染、无公害。 ◆使用温度宽-55℃～850℃；热膨胀系数接近硅，简化功率模块的生产工艺。优越性 ◆陶瓷基板的热膨胀系数接近硅芯片，可节省过渡层mo片，省工、节材、降低成本； ◆减少焊层，降低热阻，减少空洞，提高成品率； ◆在相同载流量下 0.3mm厚的铜箔线宽仅为普通印刷电路板的10%； ◆ 优良的导热性，使芯片的封装非常紧凑，从而使功率密度大大提高，改善系统和装置的可靠性； ◆

超薄型(0.25mm)陶瓷基板可替代beo，无环保毒性问题； ◆载流量大，100a电流连续通过1mm宽0.3mm厚铜体，温升约17°C；100a电流连续通过2mm宽0.3mm厚铜体，温升仅5°C左右； ◆热阻低，10×10mm陶瓷基板的热阻0.63mm厚度陶瓷基片的热阻为0.31k/w
，0.38mm厚度陶瓷基片的热阻为0.19k/w，0.25mm厚度陶瓷基片的热阻为0.14k/w。 ◆
绝缘耐压高，保障人身安全和设备的防护能力。 ◆
可以实现新的封装和组装方法，使产品高度集成，体积缩小。

本产品的加工定制是是，品牌是卓立森，型号是ZLS-0023，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是陶瓷，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是合成纤维基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价